

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于在手订单情况的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）从事对先进集成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的清洗设备、电镀设备、无应力抛光设备、立式炉管设备、前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备等的开发、制造和销售。2024年以来，国内半导体行业设备需求持续增长，公司凭借技术优势、产品成熟度和市场认可度，不断深耕现有市场、拓展新市场。为了让投资者更好地了解公司经营情况，现将截至2024年9月30日的在手合同订单情况公告如下：

一、截至2024年9月30日在手订单情况

截至2024年9月30日，公司在手订单总金额为676,459.52万元（含已签订合同及已中标尚未签订合同金额），详情如下表：

项目	截至2024年9月30日 (万元)	截至2023年9月27日 (万元)	增减幅度(%)
已签订合同订单	676,459.52	652,569.01	3.66
已中标尚未签订合同订单	0.00	27,006.98	-100.00
在手订单合计	676,459.52	679,575.99	-0.46

二、相关说明及风险提示

1、针对已中标但未签订合同的订单，因涉及相关手续办理，截至公告披露日，公司尚未与招标人就本项目签订正式合同，所涉合同签署时间、履约安排、履约条款及最终金额尚存在不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认；在手订单含已向客户交付但尚未根据中国会计准则获得客

户确认收货的设备订单及将于未来交付的设备订单；

2、以上订单受具体执行、实施进度等因素影响，对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性；在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，部分订单可能会存在部分或全部无法履行或终止的风险；

3、以上在手订单数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公司全年营业收入、净利润等财务数据，仅供投资者及时了解公司日常经营概况。具体准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年10月1日